

3CS프로그램 기업 참가 계획서

1

기술적 혹은 비즈니스상의 주요 애로사항

- ◆ 고효율 냉각 및 방열 접촉 구조의 열전소자를 활용한 냉풍 기술 개발을 완료하여 상용 선풍기 대비 1~2도 낮은 냉풍 구현에 성공하였지만, 해당 기술을 실제 시장에 적용할 구체적인 애플리케이션(활용처 및 사용 시나리오) 발굴에 어려움을 겪고 있음

2

애로사항이 미치는 영향

- ◆ 적합한 애플리케이션 및 타겟 시장 미설정 시 신기술 사장 위험 발생
- ◆ 제품 상용화 및 출시 지연으로 인한 초기 연구개발 비용 회수 불가
- ◆ B2B 및 B2C 신규 시장 진입 실패에 따른 기업 매출 증대 한계 직면

3

학생들이 해당 문제를 해결하는 데 있어 고려해야할 기술적, 환경적 제약 조건

- ◆ 내부 부품 규격 수용 필수 : 방열핀(40*40*15mm), 열전소자(40*20*5mm), FAN(50*50*15mm)
- ◆ 예상 크기 55*55*92(mm), 중량 170g 내외 준수
- ◆ 다목적 장착을 위한 직관적이고 견고한 거치 및 결합 구조 고안 필요
- ◆ 소음저감 기술 및 입체 송풍을 위한 유로구조(Airvent)를 유기적으로 반영한 디자인 설계

4

기업의 기술적 문제 해결을 통해 기대하는 효과 또는 성과

- ◆ 기존 안전모 부착 외 유모차, 자전거, 데스크탑 등 일상생활 영역으로 애플리케이션 범위 확장. 산업 현장의 온열질환 예방용품 조달 시장(한국산업안전보건공단 등) 진입 기반 마련. 폭넓은 B2C 신규 시장 창출을 통한 기업 매출 증대

5

3CS 참여기업으로 선정시 학생팀의 문제 해결 활동에 필요한 기본 정보 (데이터, 샘플 등)를 제공할 수 있습니까?

☒ 예 ☐ 아니오 ☐ 기타(설명)

6

학생들의 아이디어 도출 및 프로젝트 수행을 위한 실무자 멘토링 및 중간 점검에 협조할 수 있습니까?

- ☒ 정기적인 피드백 가능
- ☐ 간헐적 피드백만 가능
- ☐ 어렵다 (사유 기재)

7

프로그램 기간 중 학생들과의 온/오프라인 미팅(최소 월 1회 이상)에 참여할 의사가 있습니까?

- ☒ 예 ☐ 온라인만 가능 ☐ 아니오 (사유 기재)